

NDiS・Neu ^{series}

Interactive Signage Platform Product Selection Guide

スマートリテール・サイネージソリューション セレクトカタログ Vol.4

NDiSシリーズ導入事例 (オリエンタルホテル東京ベイ / JR東京駅)

スマートシティコントローラ Neuシリーズ

デジタルサイネージプレーヤ NDiS Bシリーズ

マルチディスプレイプレーヤ NDiS Vシリーズ

SDM-Lベースサイネージプラットフォーム NDiS Sシリーズ

OPSモジュール NDiS Mシリーズ

国内向けサポートサービスとオプションサービスのご案内

ODMサービス / ネクスコムIoTソリューション



NEXCOM導入事例1 千葉・浦安市

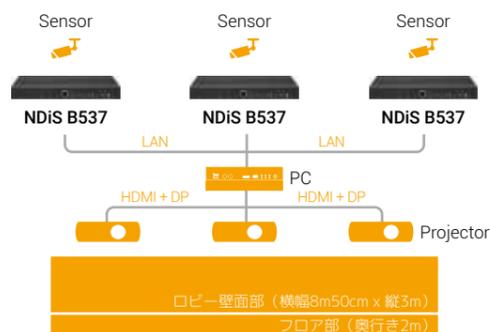
インタラクティブ プロジェクションマッピング NDiS B537

Interactive
Projection
Mapping

フロントカウンターの混雑緩和を促進し 子供たちが楽しめる空間の提供を助ける NEXCOM の STB

世界でも有数のアミューズメントパークのパートナーホテルであるオリエンタルホテル東京ベイは、主要顧客となるファミリー層の顧客満足度の更なる向上や、受付カウンターでの混雑緩和を目指すと同時に、先進的なデザインを求めた結果、Playful Forest (プレイフルフォレスト) をコンセプトにしたロビー施設のリニューアルに伴い、国内ホテル初となる、インタラクティブプロジェクションマッピングを導入することとなりました。

導入以前は、アミューズメントパークの閉園に合わせてファミリー客が押し寄せていた受付カウンターも、子供たちや同伴のお客様が、プロジェクションマッピングのあるロビー壁面側へ流れることで、混雑が解消され、チェックイン手続きがスムーズに行えるようになり、ロビー全体が宿泊客やレストランの利用客にホテルの施設を十分楽しんでいただける場となっています。



ロビー壁面のスクリーンは、横幅約 8.5m x 高さ 3m、壁面から続くフロア部分は 2m の奥行きがあり、約 7m 手前のガゼボ (休憩施設) 上に設置された 3 台のプロジェクタから、プロジェクションマッピングを投影しています。壁面上部に設置した 3 台の NEXCOM 製 STB (セットトップボックス) で受信したセンシング情報は、Ethernet でレンダリング用の PC に送られ、HDMI や DP ポートを介し接続された 3 台のプロジェクタが、センサで捉えた人物の動きに合わせた映像を出力します。

NEXCOM のファンレス仕様の STB は、フロア部に敷かれたカーペットからの埃にも強く、容易なメンテナンスで長期間にわたって利用いただけます。また、パルコススペースシステムズ社が提供する人気のコンテンツは、特殊な動きで登場する隠れキャラもあり、子供たちに大人気で、2019 年 10 月からは第二弾となるスカイサーカスのインタラクティブプロジェクションマッピングでお客様をお迎えしています。

NDiS B537

- ・ 第 7 世代 Intel® Core™ プロセッサ
- ・ Intel® HD630 Graphics
- ・ 2 画面ディスプレイ対応 HDMI x2 ポート
- ・ 薄型ファンレスデザイン

インタラクティブ
プロジェクション
マッピング
「スカイサーカス」



Digital
Signage

NEXCOM導入事例2 東京・千代田区

デジタルサイネージプレーヤ NDiS B535

JR 東京駅「東京中央通路電照デジタルシートセット」※イメージ

NEXCOM のサイネージプレーヤが支える JR 東京駅の 4K 対応デジタルサイネージ「J・AD ビジョン」

デジタルサイネージとシート広告をセット展開する「東京中央通路電照デジタルシートセット」では、2015 年のリニューアルの際、JR 東日本エリアに展開する J・AD ビジョンおよび J-Spot ビジョンでは初の 4K 対応サイネージを採用しました。

日本を代表するターミナル駅の一つである JR 東京駅、その中でも流動率の高い中央通路コンコースには、8 本の柱に 14 面のデジタルサイネージ、J・AD ビジョンが設置されており、一画面に 1 台、

4K2K 放映用 STB (セットトップボックス) として、ネクスコム の NDiS B535 が使用されています。

70 インチ・ディスプレイ放映対応のリニューアルにより、従来の 2K サイネージ (1,920x1,080 ピクセル) から、高解像度 4K (3,840x2,160 ピクセル) の表示が可能となり、データ配信には高速データ通信 WiMAX を採用、曜日別・時間帯別・各ディスプレイ別にフレキシブルなコンテンツの表示変更が可能となります。

4K 画質対応に加え、従来のハイビジョン画質の映像をより高画質で表示できるようになり、より訴求力のある広告展開を可能にしています。

4K対応 J・ADビジョン



電照シート広告

NDiS B535

- ・ 第 6 世代 Intel® Core™ プロセッサ
- ・ Intel® HD530 Graphics
- ・ 3 画面ディスプレイ対応 HDMI x3 ポート
- ・ ファンレスデザイン



Neu-X100-N3350/Neu-X100-N4200

新型 Intel® プロセッサ搭載 用途に合わせた 2 タイプのスマートシティコントローラ



Neu-X100 シリーズは、デジタルサイネージのみならず、様々な目的に使用可能な低価格スマートシティコントローラです。2種類のCPUバリエーションにより、目的に合わせた選択が可能です。デジタルサイネージ用STBからIoTゲートウェイまで、使用環境を選ばない超小型で低価格なファンレスコンピュータです。



超小型

Neu-X100-N3350 :

Intel® Celeron® N3350 (Dual Core, 1.10GHz)
Intel® HD Graphics 500

Neu-X100-N4200 :

Intel® Pentium® N4200 (Quad Core, 1.10GHz)
Intel® HD Graphics 505

- DDR3L SO-DIMMスロット x 1 最大8GB
- RS232/422/485 x 1, LAN x 2, USB3.0 x 2
- HDMI x 2
- Mini-PCIe スロット x 1
- M.2 x 1 (ストレージ)
- SIMスロット x 1
- +19V / 45W ACアダプタ付属

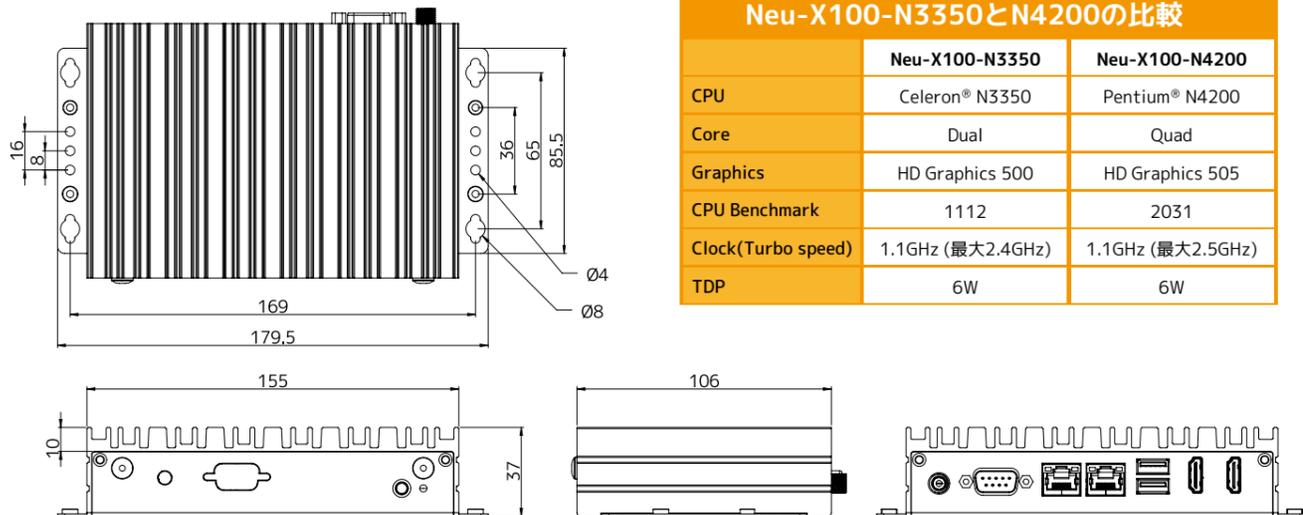
外形寸法 155mm (W) x 106mm (D) x 37mm (H)

重量 0.84 kg

動作温度範囲 -5°C ~ 50°C

Neu-X100-N3350とN4200の比較

	Neu-X100-N3350	Neu-X100-N4200
CPU	Celeron® N3350	Pentium® N4200
Core	Dual	Quad
Graphics	HD Graphics 500	HD Graphics 505
CPU Benchmark	1112	2031
Clock (Turbo speed)	1.1GHz (最大2.4GHz)	1.1GHz (最大2.5GHz)
TDP	6W	6W



Neu-X300-Q370/Neu-X300-H310

第8世代 Intel® Core™ プロセッサ搭載 4K ビデオ再生対応スマートシティコントローラ

M.2 LTE モジュールは
2020年Q1販売予定



Neu-X300 シリーズは、デジタルサイネージのみならず、様々な目的に使用可能なハイパフォーマンスなスマートシティコントローラです。ソケットタイプの第8世代 Intel® Core™ プロセッサを搭載でき、Core™ i7 から Celeron® (オプション) まで目的に合わせて選択いただけます。また 2 種類のチップセットにより、バリュー版と、高性能版を用意しました。



CPUタイプ：第8世代 Intel® Core™ プロセッサ
搭載可能CPU：

Core i3-8100T (Quad Core, 3.10GHz)
Core i5-8500T (6 Core, 2.10GHz)
Core i7-8700T (6 Core, 2.40GHz)

Neu-X300-Q370 : Intel® Q370
Neu-X300-H310 : Intel® H310

- Intel® UHD Graphics 630
- DDR4 SO-DIMM スロット x 1 最大32GB
- RS232/422/485 x 1, LAN x 2, USB3.0 x 4
- HDMI x 3 (Q370) / HDMI x 2 (H310)
- Audio-out x 1
- M.2 x 1 (ストレージ), TPM2.0 (Q370のみ)
- M.2 x 1 (LTE)
- SIMスロット x 1
- +12V / 96W ACアダプタ付属

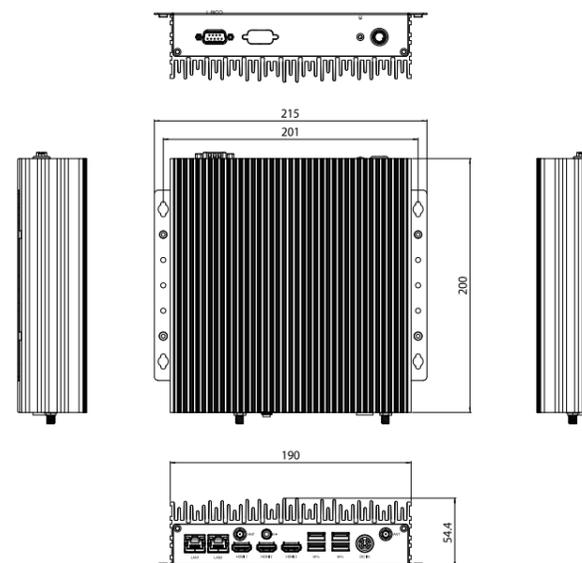
外形寸法 190mm (W) x 200mm (D) x 54.4mm (H)

重量 2.6 kg

動作温度範囲 -5°C ~ 45°C

Neu-X300-Q370とH310の比較

	Neu-X300-Q370	Neu-X300-H310
Chipset	Q370	H310
HDMI2.0	3	2
TPM2.0	あり	なし



NDiS B537

第7世代 Intel® Core™ プロセッサ搭載 4K ビデオ再生対応スリム型デジタルサイネージプレーヤ



NDiS B537 は、第7世代 Intel® Core™ プロセッサを搭載し、従来機 (NDiS B535) に比べ約 10% の性能向上を実現しました。さらにケースも従来の 52mm から 33mm へと約 35% スリム化し、よりフレキシブルな設置を可能とします。オプションの LTE モジュールを搭載すると直接通信可能となり、STB のみならず高性能デジタルサイネージ向け IoT ゲートウェイとしても使用可能です。



NDiS B537

CPUタイプ：第7世代 Intel® Core™ プロセッサ
搭載可能CPU：
Core i3-7101E (Dual Core, 3.9GHz)
Core i5-7500T (Quad Core, 2.7GHz)
Core i7-7700T (Quad Core, 2.9GHz)

• Intel® H110

- Intel® HD630 Graphics
- DDR4 SO-DIMM スロット x 2 最大32GB
- RS232 x 2, LAN x 1, USB3.0 x 4
- HDMI x 2, Line-out x 1, Mic x 1
- Mini-PCIe スロット x 1, M.2 x 1 (LTE)
- 2.5インチベイ x 1
- SIMスロット x 1
- +12V / 96W ACアダプタ付属

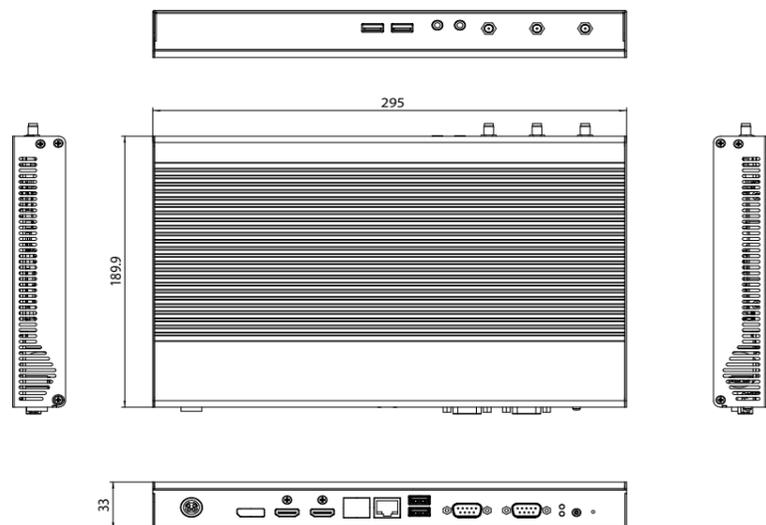
外形寸法 295mm (W) x 189.9mm (D) x 33mm (H)

重量 2.5 kg

動作温度範囲 -10°C ~ 45°C



NDiS B537 背面



NDiS B535

第6世代 Intel® Core™ プロセッサ搭載 4K ビデオ再生対応デジタルサイネージプレーヤ



NDiS B535 は B533 を継承し、同一デザインに第6世代 Intel® Core™ プロセッサを搭載、Intel® HD530 Graphics により、4K のマルチ出力の多彩な映像表現を可能にしました。ケースにはアルミを使用し、ファンレスとしての放熱に重点をおいて設計しました。さらにオプションでケース内に2個のファンが搭載可能で、劣悪な温度環境にも対応いたします。



NDiS B535

CPUタイプ：第6世代 Intel® Core™ プロセッサ
搭載可能CPU：
Core i3-6100TE (Dual Core, 2.7GHz)
Core i5-6500TE (Quad Core, 2.3GHz)
Core i7-6700TE (Quad Core, 2.4GHz)

• Intel® Q170

- Intel® HD530 Graphics
- DDR4 SO-DIMM スロット x 2 最大32GB
- RS232 x 4, LAN x 2, USB3.0 x 6
- HDMI x 3, Line-out x 1, Mic x 1
- Mini-PCIe スロット x 1, M.2 x 1 (LTE)
- 2.5インチベイ x 1, M.2 x 1 (ストレージ)
- SIMスロット x 1
- +12V / 96W ACアダプタ付属

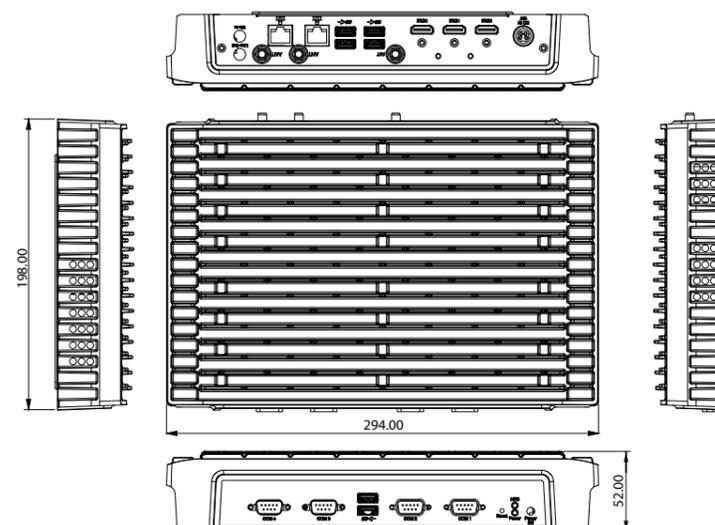
外形寸法 294mm (W) x 198mm(D) x 52mm (H)

重量 3.5 kg

動作温度範囲 0°C ~ 40°C



NDiS B535 背面



NDiS B328-KI3

第7世代 Intel® Core™ プロセッサ搭載 4K ビデオ再生対応デジタルサイネージプレーヤ

NDiS B328-KI3 は、第7世代 Intel® Core™ i3-7100U をオンボードで搭載し、バリューとハイパフォーマンスの中間的な存在で、一般的なデジタルサイネージのほとんどに対応できます (Intel® HD620 Graphics)。価格と消費電力 (TDP 15W) を抑えたミドルレンジ仕様で、ストレージは底面より交換可能、高メンテナンス性と薄型のスタイリッシュなデザインを兼ね備えたファンレス STB です。



NDiS B328-KI3

- Intel® Core™ i3-7100U (Dual Core, 2.4GHz)
- Intel® HD620 Graphics
- DDR4 SO-DIMM スロット x 2 最大32GB
- RS232 x 1, LAN x 1, USB3.0 x 6
- HDMI x 2, Line-out x 1, Mic x 1
- 2.5インチベイ x 1, M.2 x 1 (ストレージ)
- +19V ACアダプタ付属

外形寸法 224.4mm (W) x 147.4mm (D) x 35mm (H)

重量 1.5 kg

動作温度範囲 -20°C ~ 50°C (SSD); 0°C ~ 50°C (HDD)



NDiS B328-KI3 背面

NDiS B327

Intel® Celeron® N3060 プロセッサ搭載 4K ビデオ再生対応デジタルサイネージプレーヤ



NDiS B327 は、Intel® Celeron® N3060 をオンボードで搭載、エントリーレベルのシンプルなデジタルサイネージに最適です。4K 再生をはじめ、USB ポート x6 や、既存のモニタをそのまま活用できる VGA ポートも搭載しています。Intel® HD400® Graphics を搭載し、バリューモデルとして気軽に導入可能なファンレス STB です。



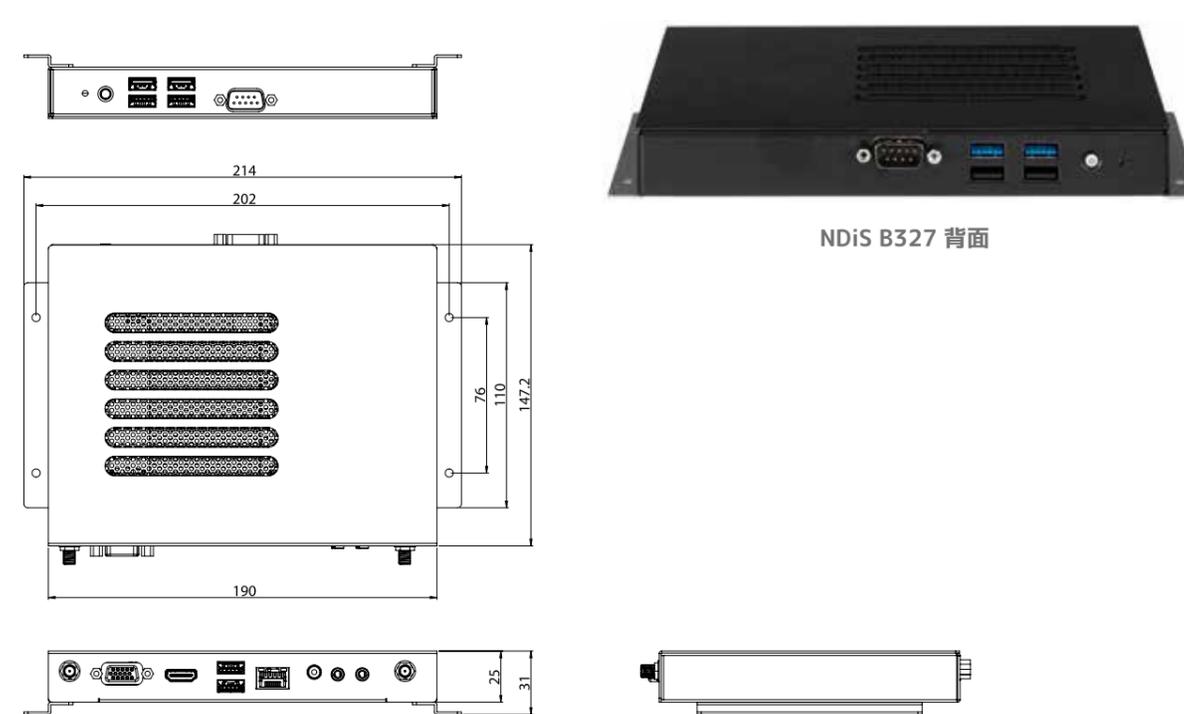
NDiS B327

- Intel® Celeron® N3060 (Dual Core, 1.6GHz)
- Intel® HD400 Graphics
- DDR3L SO-DIMM スロット x 2 最大8GB
- RS232 x 1, LAN x 1, USB3.0 x 4, USB2.0 x 2
- HDMI x 1, VGA x 1, Line-out x 1, Mic x 1
- Mini-PCIe スロット x 1, M.2 x 1 (LTE)
- 2.5インチベイ x 1, M.2 x 1 (ストレージ)
- SIMスロット x 1
- +19V ACアダプタ付属

外形寸法 190mm (W) x 149mm (D) x 25mm (H)

重量 1.2 kg

動作温度範囲 0°C ~ 40°C



NDiS B327 背面

NDiS V1000

AMD Ryzen™ V シリーズ Quad Core プロセッサ搭載 マルチディスプレイエンベデッドコンピュータ

M.2 LTE モジュールは
2020 年 Q1 販売予定



NDiS V1000 は、高性能でハイコストパフォーマンスな AMD Ryzen 組込み型 V1000 プロセッサファミリーの V1605B を搭載し、「Zen」CPU と「Vega」GPU アーキテクチャによる最新型 SoC により、高性能なグラフィックスとマルチメディア処理を実現しました。4 ポートの HDMI によりインパクトのある多彩な表現が可能となります。小型でハイパフォーマンスなファンレス STB です。



NDiS V1000

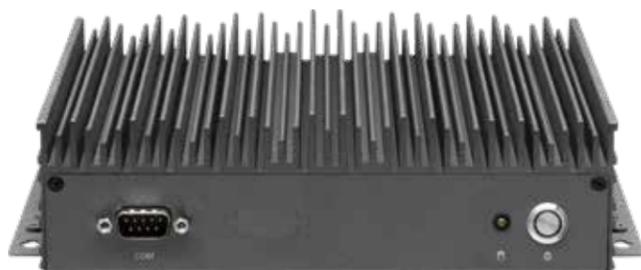
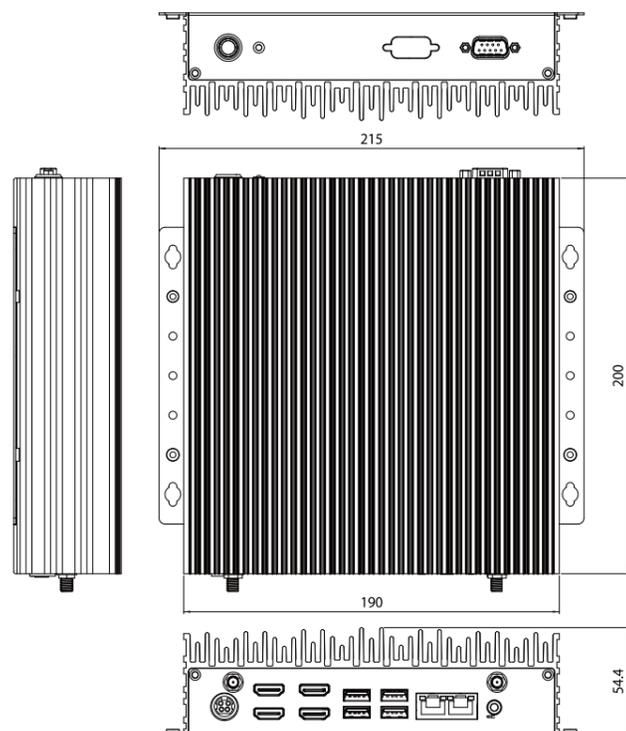
- AMD Ryzen™ V1605B (Quad Core, 2GHz)
- AMD Radeon™ Vega 8 Graphics
- DDR3 SO-DIMM スロット x 2 最大32GB
- RS232/422/485 x 1, LAN x 2
- USB3.0 x 4

- HDMI x 4, Line-out x 1
- M.2 x 1 (LTE)
- M.2 x 1 (ストレージ)
- SIMスロット x 1
- +12V / 120W ACアダプタ付属

外形寸法 190mm (W) x 200mm (D) x 54.4mm(H)

重量 2.6 kg

動作温度範囲 0°C ~ 40°C



NDiS V1000 背面

NDiS B336R

Intel® Atom™ E3950 プロセッサ搭載 ハイパフォーマンス STB



NDiS B336R は、最新 Intel® Atom™ プロセッサ E3950 を搭載、高さ 21mm の超薄型デジタルサイネージ向け STB です。薄型のため、設置の際のレイアウトが容易になります。Intel® HD505 Graphics を搭載し、エントリーレベル (シンプルなインターフェース) ながらも、フレキシブルな使い方が可能です。



NDiS B336R

超薄型



NDiS B336R 背面

- Intel® Atom™ E3950 (Quad Core, 2.0GHz)
- Intel® HD505 Graphics
- DDR3L SO-DIMM スロット x 2 最大16GB
- RS232 x 1, LAN x 1, USB3.0 x 5
- HDMI x 2, DisplayPort x 1, Line-out x 1, Mic x 1

- Mini-PCIe スロット x 1, M.2 x 1 (LTE)
- 2.5インチベイ x 1
- SIMスロット x 1
- +19V / 65W ACアダプタ付属

外形寸法 259mm (W) x 147mm (D) x 21mm (H)

重量 1.3 kg

動作温度範囲 -10°C ~ 60°C (SSD); 0°C ~ 40°C (HDD)

NDiS B533

第4世代 Intel® Core™ プロセッサ搭載 4K ビデオ再生対応デジタルサイネージプレーヤ

2020 年 販売終了予定



NDiS B533 前面



NDiS B533 背面

- CPUタイプ：第4世代 Intel® Core™ プロセッサ
搭載可能CPU：
- Core i3-4350T (Dual Core, 3.1GHz)
 - Core i5-4570TE (Quad Core, 2.7GHz)
 - Core i7-4770TE (Quad Core, 2.3GHz)

- Intel® Q87
- Intel® HD4600 Graphics

- DDR3 SO-DIMM ソケット x 2 最大16GB
- RS232 x 2, LAN x 2, USB3.0 x 4
- HDMI x 3, Line-out x 1, Line-in x 1, SPDIF x 1
- Mini-PCIe スロット x 2
- 2.5インチベイ x 1, SATA DOM x 1
- SIMスロット x 1
- +12V / 80W ACアダプタ付属

外形寸法 294mm (W) x 198mm (D) x 52mm(H)

重量 3.5 kg

動作温度範囲 0°C ~ 40°C

NDiS S538

第6世代 Intel® Core™ プロセッサ搭載 Intel® SDM-L ベースデジタルサイネージプラットフォーム

M.2 LTE モジュールは
2020年Q1販売予定



SDM-L (Intel® Smart Display Module - Large) は、IoT 時代のデジタルサイネージ向け専用モニタにプラグインして使用する、OPS に次ぐ規格で、よりハイパフォーマンスな CPU の搭載や、ホットスワップなどの機能を有しています。第6世代 Intel® Core™ プロセッサ搭載により、3系統の独立した4K2Kビデオ出力をサポートします。銅製の専用ヒートシンクを搭載し、冷却効果に優れ、高負荷な複数のハイフレームレート動画の再生も可能です。オールインワンサイネージ、高性能インタラクティブメディアプレーヤ、ビデオウォールなどに対応します。



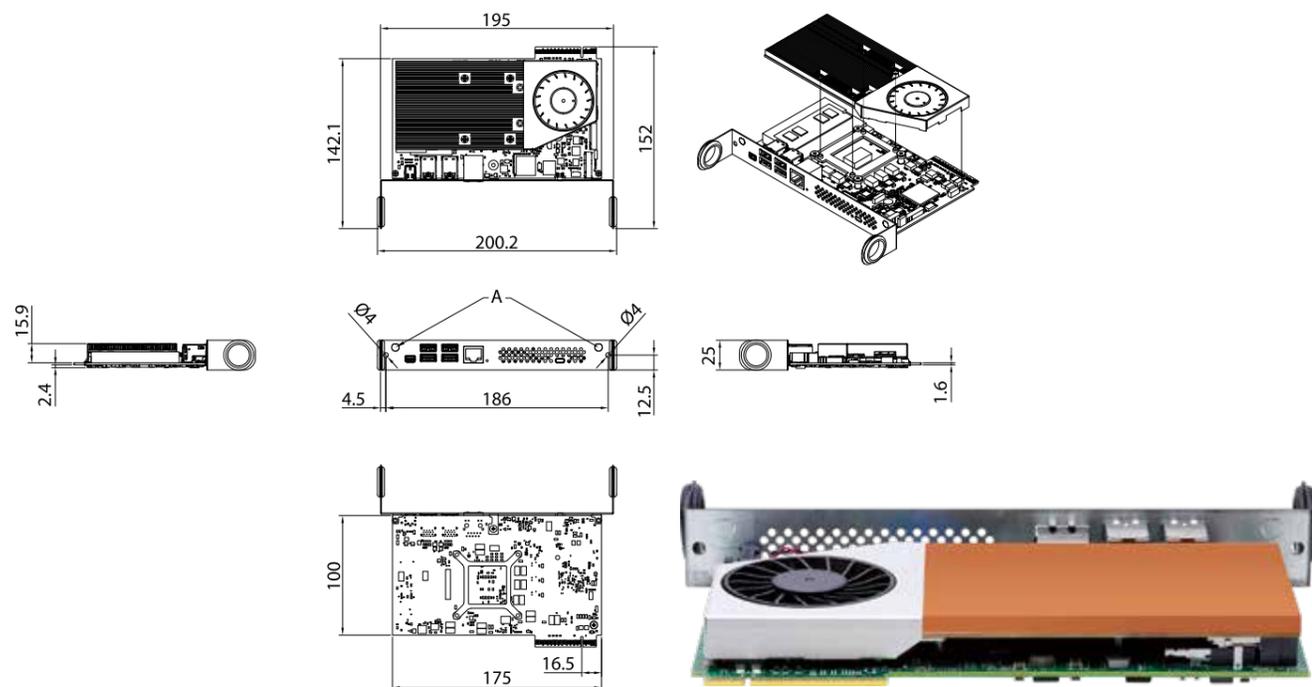
NDiS S538

- 第6世代 Intel® Core™ プロセッサ
- Intel® Q170
- Intel® HD530 Graphics
- DDR4 SO-DIMM スロット x 2 最大32GB
- LAN x 1, USB3.0 x 4

- Mini DisplayPort++ x 1
- M.2 x 1 (LTE)
- M.2 x 1 (ストレージ)
- SIMスロット x 1
- +12V ACアダプタ付属

外形寸法 175mm (W) x 100mm (D) x 20mm (H)

動作温度範囲 0°C ~ 55°C



NDiS S538 背面

NDiS M324

Celeron® J1900 プロセッサ搭載



NDiS M324

- Intel® Celeron® J1900
- DDR3L SO-DIMMスロット x 2 最大8GB
- LAN x 1
- USB3.0 x 3, USB2.0 x 1
- HDMI x 1
- Line-out x 1, Mic x 1
- Mini-PCIe スロット x 1
- 2.5インチベイ x 1
- SIMスロット x 1

外形寸法 200mm (W) x 119mm (D) x 30mm (H) 動作温度範囲 0°C ~ 45°C

NDiS M335

Celeron® N3160 プロセッサ搭載



NDiS M335

- Intel® Celeron® N3160
- Intel® HD Graphics
- DDR3L SO-DIMMスロット x 2 最大8GB
- LAN x 1
- USB3.0 x 2, USB2.0 x 2
- HDMI x 2
- Line-out x 1, Mic x 1
- Mini-PCIe スロット x 1
- 2.5インチベイ x 1, M.2 x 1 (ストレージ)
- SIMスロット x 1

外形寸法 200mm (W) x 119mm (D) x 30mm (H) 動作温度範囲 0°C ~ 45°C

NDiS M535

第6世代 Intel® Core™ プロセッサ搭載 (BGA タイプ) 4K 対応 OPS デジタルサイネージプレーヤ



NDiS M535

- NDiS M535 : i5-6440EQ (Quad Core, 2.7GHz)
- NDiS M535-6820EQ : i7-6820EQ (Quad Core, 2.8GHz)
- Intel® QM170
- Intel® HD530 Graphics
- DDR4 SO-DIMM スロット x 2 最大32GB

- LAN x 1, USB3.0 x 2
- HDMI x 1, Mini DisplayPort++ x 1, Line-out x 1, Mic x 1
- Mini-PCIe スロット x 1
- 2.5インチベイ x 1
- Micro SIMスロット x 1

外形寸法 200mm (W) x 119mm (D) x 30mm (H)

動作温度範囲 0°C ~ 45°C

NDiS M537

第7世代 Intel® Core™ プロセッサ搭載 OPS+ デジタルサイネージプレーヤ



NDiS M537

- CPUタイプ：第7世代 Intel® Core™ プロセッサ
搭載可能CPU：
- Core i3-7101E (Dual Core, 3.9GHz)
 - Core i5-7500T (Quad Core, 2.7GHz)
 - Core i7-7700T (Quad Core, 2.9GHz)

- Intel® Q170
- Intel® HD630 Graphics
- DDR4 SO-DIMM スロット x 2 最大32GB
- RS232 x 1, LAN x 1, USB3.0 x 2

- Mini DisplayPort++ x 1
- Line-out x 1, Mic x 1
- M.2 x 1 (ストレージ)

外形寸法 200mm (W) x 119mm (D) x 30mm (H)

動作温度範囲 0°C ~ 45°C

充実の国内向けサポートメニュー

ミニマムロットは1台から 1台より受注

最低発注数は、システム1台より承ります。

信頼性を高めます 出荷前検査の実施

出荷前にエージングテスト、負荷テスト等を実施します。貴社ご指定の検査や評価レポートの添付などにも対応します。

面倒な組立てはお任せ アセンブリサービス

ご希望のCPU、メモリ、ストレージ、拡張カードなど、各種アセンブリサービスもお任せ下さい。

安心の国内サポート 修理・技術サポート

修理や技術サポートを実施します。修理レポートの作成など、国内でのサポート体制を整えています。

各種キitting インストール・キitting

ご希望のOS・アプリケーションのインストール、ご指定のCDなどの添付品の同梱等、各種キitting作業も承ります。

貸出無料 評価機貸出

ネクコムの製品を無料にてお貸出しします。導入前のパフォーマンスの確認や評価にご利用ください。

修理サポートサービス

18ヶ月間の無償修理保証(標準保証)

標準品は弊社発送日より18ヶ月間の無償修理保証が添付されています。(保証書を発行しない出荷履歴管理システムにより、出荷商品の詳細は弊社で管理しております)

国内での修理対応

ネクコム・ジャパンにて修理が可能な場合は、国内修理により短期間にて返却します。

センドバックによる受付

修理品を弊社まで発送頂き、弊社にて不良状況の確認・解析・修理を実施します。

本社(NEXCOM International)での修理対応

ネクコム・ジャパンにて修理が不可能な場合は、本社のRMAセンターへ発送します。

その他オプションサービス

最長5年延長保証のオプションサポート ワランティプログラム

ネクコム・ジャパン ワランティプログラムは、NDiSシリーズ等の弊社製品をシステムで購入いただいた際に、所定の費用を購入時、お支払いいただくことにより、最長5年間修理費用が無償になるプログラムです。

※詳細は別紙ワランティ規定をご覧ください。

何回でも修理費無料!

年8%とリーズナブル

2,3,4,5年間の選択可

1台から対応

標準保証 18か月 + 延長保証(オプション)

安心の
延長保証

最大5年間

USBでメモリレポートし、簡単リカバリ リカバリ USB メモリ添付サービス

製品を購入時にリカバリ USB メモリ添付サービスをオプションにてご利用頂けます。万が一の障害発生時に、CD/DVDドライブがなくてもPCを製品出荷時の状態に戻します。また、お客様のアプリケーションを含めたオリジナルのリカバリ USB メモリも作成可能です。(※ Windows OS のみ対応となります。日本語版が標準ですが、英語版も対応可能です。)



アプリケーションも含めて複数のバックアップファイルが作成できる!

【USBリカバリの資料】

NEXCOM テクニカルサポートページ
カタログ・マニュアルダウンロード



カラーチェンジやインターフェースのカスタマイズ ステッカー製作などオリジナルブランド品の制作をお手伝い

ODMソリューションその① キittingサービス

Windows や Linux や貴社専用のアプリケーションのインストールなど各種キittingサービスを行います。貴社での面倒なインストール作業を削減し、到着したその日からすぐにお使い頂けます。

ODMソリューションその② ソフトのカスタマイズ

BIOS のカスタマイズ(ロゴ表示・デフォルト値の変更)や WindowsOS のイメージ作成・構築をはじめ各種アプリケーション開発のお手伝いも可能です。詳しくは弊社営業部までご相談下さい。弊社パートナーをご紹介させて頂きます。

ODMソリューションその③ パネルのステッカー製作

ステッカーの製作は200枚から承ります。ステッカーを弊社でお預かりし、本体ご注文時に貼り付けて出荷致します。



ODMソリューションその④ カラーチェンジ

ケースのカラーチェンジは200台ロットより対応致します。また社名やロゴ、インターフェース名の変更も可能です。

ODMソリューションその⑤ ボードのカスタマイズ

ボード上のコンポーネントの取外しや変更など、I/O や機能のカスタマイズが可能です。



ODMソリューションその⑥ 各種認証取得

標準にて CE と FCC 認証を取得していますが、ご希望に合わせて、VCCI や UL、CCC などの取得手続きを別途行います。

ネクコム・ジャパンオリジナル ネクコム IoT ソリューション

LTE通信内蔵対応、モバイルネットワークで 遠隔制御・稼働監視・遠隔保守・メンテナンスを実現

LTE 通信専用アンテナ一覧



メーカー	サガ電子工業				日本アンテナ	キャセイ・トライトック	
品名	1 ルーフトップアンテナ	2 マグネットアンテナ	3 ダイポールアンテナ	4 ダイポールアンテナ	5 無指向性アンテナ		
外形寸法 (mm)	154 x 34 x 10	154 x 34 x 10	-	-	-	-	-
ケーブル長 (m)	5	7	5	10	5	-	2
動作温度	-30°C ~ 85°C				確認中	-	-40 ~ 70°C
取付方法	ねじ(M3)		マグネット		-	本体に直付け	両面テープ
NTTドコモ対応	○		非対応		○	○	○
ソフトバンク対応	○		○		○	○	○
MOQ	なし		なし		要相談	なし	なし

SIMCom Wireless Solution社製



NTTドコモLTE/3G対応モジュール

型式名	SIM7100JC-MPCle (LTE/3G)
アクセス方式	FDD/TDD-LTE
ダウンリンク	最大100Mbps (LTE)
アップリンク	最大50Mbps (LTE)
動作温度	-30~80°C

ソフトバンクLTE/3G対応モジュール

型式名	SIM7100JE-MPCle (LTE/3G)
アクセス方式	FDD-LTE
ダウンリンク	最大100Mbps (LTE)
アップリンク	最大50Mbps (LTE)
動作温度	-30~80°C

●会社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。●このカタログに記載されている内容は製品改良のため、予告なく仕様・デザイン等を変更する場合があります。●このカタログの記載内容は2019年11月現在のものです。



株式会社ネクコム・ジャパン

〒108-0014 東京都港区芝4-11-5 田町ハラビル9階
TEL : 03-5419-7830 FAX : 03-5419-7832
Email : sales@nexcom-jp.com
URL : <http://www.nexcom-jp.com>

本製品に関するお問い合わせは